

Title (en)

Device for applying glue and method for cleaning same

Title (de)

Vorrichtung zum Auftragen von Leim sowie Verfahren zum Reinigen derselben

Title (fr)

Dispositif d'application de colle et procédé de nettoyage de celui-ci

Publication

**EP 2392408 A1 20111207 (DE)**

Application

**EP 11168250 A 20110531**

Priority

DE 102010029676 A 20100602

Abstract (en)

The device (1) has a nozzle unit (4) with glue outlet openings (6) and glue supply lines (11) that are selectively supplied with glue by glue valves (8). Glue lines (10) introduce the glue from a glue chamber (9) to the valves. The supply lines are supplied with cleaning fluid i.e. water, via a connection. A fluid chamber (13) is provided independent of the glue chamber and supplies the fluid. Fluid lines (12) are discharged in the glue lines or the glue supply lines. A non-return valve (15) is associated to each fluid line. A spring supports a closing function in the non-return valve. An independent claim is also included for a method for cleaning a device for applying glue on regions of paper and plastic webs or paper and plastic web sections.

Abstract (de)

Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung zum Auftragen von Leim auf Bereiche von Papier- oder Kunststoffbahnen oder Papier- oder Kunststoffbahnabschnitten zur Herstellung von Papiersäcken. Diese Vorrichtung besteht aus einer Düseneinheit mit mehreren Leimaustrittsöffnungen und Leimzuführleitungen sowie mit Leimventilen, über welche die Leimzuführleitung selektiv mit Leim versorgbar sind, weiterhin aus einer Leimkammer, mit welcher Leim bereitstellbar ist sowie weiteren Leimleitungen, mit welchen Leim aus der Leimkammer an die Leimventile heranführbar ist, und einem Anschluss für ein Reinigungsfluid, über den zumindest Leimzuführleitungen mit dem Reinigungsfluid beaufschlagbar sind. Es ist eine von der Leimkammer unabhängige Fluidkammer vorgesehen, mit welcher das Reinigungsfluid zuführbar ist.

IPC 8 full level

**B05C 5/02** (2006.01); **B05B 15/02** (2006.01); **B05B 15/55** (2018.01)

CPC (source: EP)

**B05B 15/55** (2018.01); **B05C 5/0279** (2013.01)

Citation (applicant)

- DE 10309893 A1 20040415 - WINDMOELLER & HOELSCHER [DE]
- DE 102007032401 A1 20090115 - WINDMOELLER & HOELSCHER [DE]

Citation (search report)

- [X] US 2003080205 A1 20030501 - BORWIG MICHAEL C [US]
- [X] EP 0844068 A2 19980527 - MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP], et al
- [X] EP 2163312 A1 20100317 - ABB AG [DE]
- [A] US 5700322 A 19971223 - FORT WESLEY C [US]
- [A] WO 2004030829 A1 20040415 - WINDMOELLER & HOELSCHER [DE], et al
- [A] EP 2002898 A1 20081217 - ZIMMER MASCHB GES M B H J [AT]
- [A] US 2001042507 A1 20011122 - ROTHEN JOSEF [DE]
- [A] JP H1028917 A 19980203 - NORDSON KK

Cited by

CN114308486A; EP2916967A4; CN109744652A; CN115121443A; US9566599B2; US9724719B2

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 2392408 A1 20111207**; **EP 2392408 B1 20160406**; PL 2392408 T3 20160930

DOCDB simple family (application)

**EP 11168250 A 20110531**; PL 11168250 T 20110531